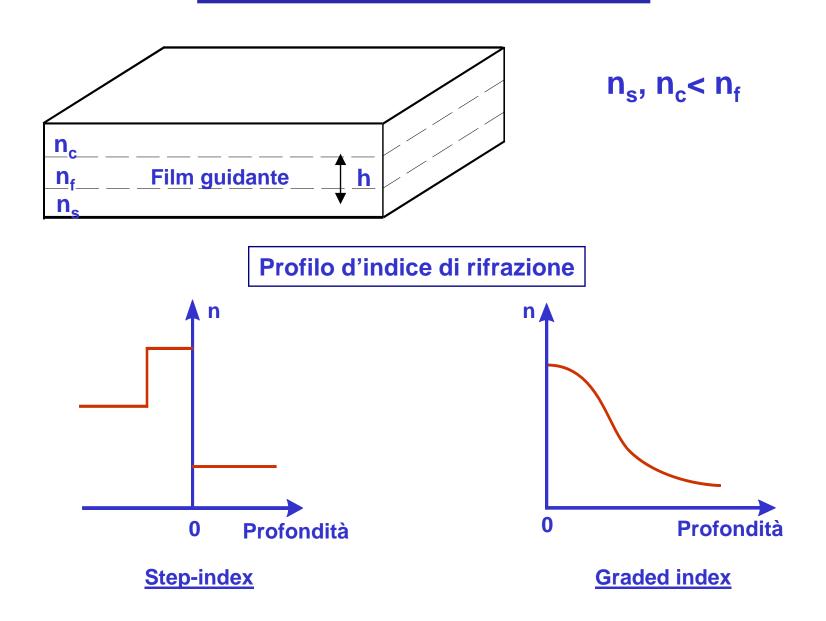
Struttura guidante



Scambio ionico: Profilo storico

? Egiziani Decorazione di piatti e vasellame in giallo ocra

X-XI sec. Mori Colorazione di vetri per finestre

XIV sec. Francia Jaune d'argent (giallo argento)

(l'argento veniva spalmato sul vetro come impasto di argilla e cloruro o solfuro di argento; mediante riscaldamento gli ioni argento diffondevano nel vetro e a contatto con ferro e altre impurità si riduceva producendo il colore caratteristico).

Anche colorazioni di rame venivano prodotte in modo simile.

1913 Prima applicazione industriale: la tempratura del vetro.

1918 Presso la Schott viene misurato il conseguente aumento

dell'indice di rifrazione.

'60 Lo *ion-stuffing* diventa un processo industriale standard.

1972 Primo (?) articolo sulla fabbricazione di guide planari ottiche

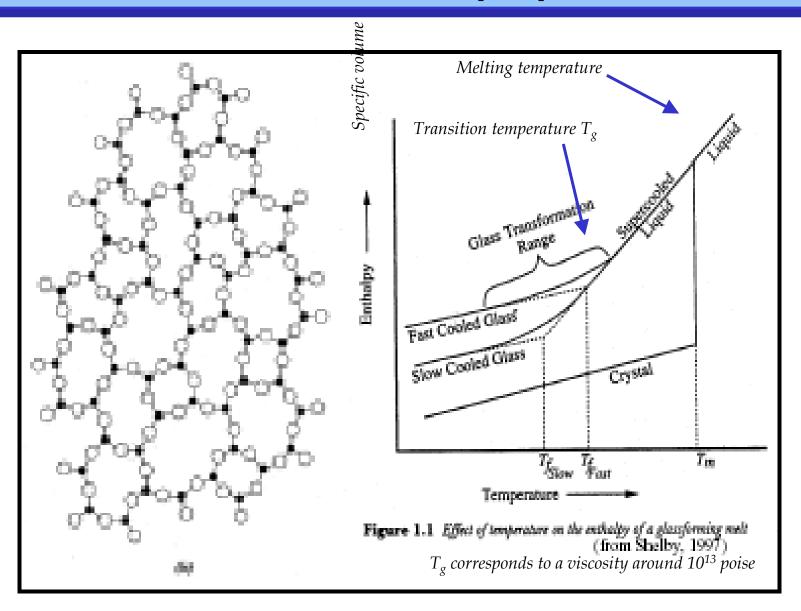
mediante diffusione indotta da campo elettrico in vetro (Izawa e

Nagakome).

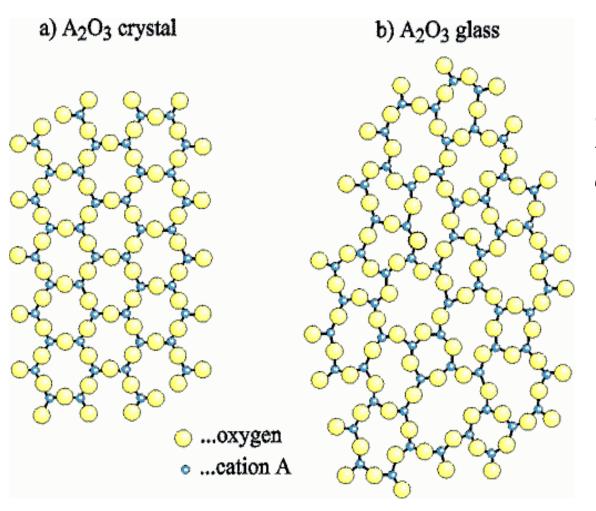
1973 Primo (?) articolo sulla fabbricazione di guide planari ottiche

mediante diffusione termica di ioni in vetro (Giallorenzi et al.).

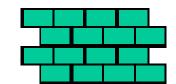
Una breve introduzione alle proprietà dei vetri

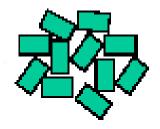


Struttura di un vetro rispetto ad un cristallo

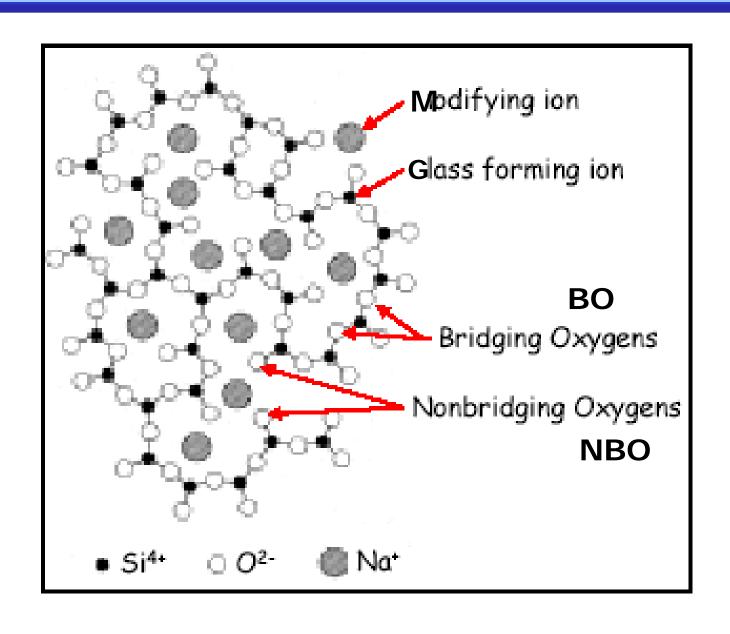


Gli stessi poliedri, ma in configurazioni differenti





Elementi formatori e modificatori di un vetro



COMPOSIZIONE DI UN VETRO

I vetri sono costituiti da una miscela di elementi (tipicamente ossidi) nelle dovute concentrazioni molari. Tali ossidi possono classificarsi in:

Formatori di reticolo o vetrificanti

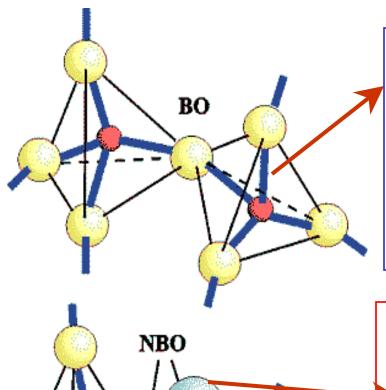
come la silice, e gli ossidi di boro, fosforo, alluminio (SiO_2 , B_2O_3 , P_2O_5 , Al_2O_3 , ecc..) che, presenti nelle maggiori concentrazioni, vanno a formare il vetro durante il suo processo di realizzazione.

Modificatori di reticolo

come il sodio, il calcio, il potassio, il piombo (e altri) con i loro rispettivi ossidi metallici Na₂O, CaO, K₂O, PbO, ecc..

Questi ultimi non generano la struttura del vetro, ma ne modificano le caratteristiche chimiche e fisiche (come, ad esempio, la sua temperatura di transizione $\mathbf{T}_{\mathbf{q}}$)

Elementi formatori e modificatori di un vetro



Na+

Na+

Unità fondamentale tetraedrica [SiO₄] di un vetro silicato.

Durante la fase di raffreddamento queste unità costituenti non si vanno ad orientare secondo una ben precisa configurazione spaziale (tipica dei reticoli cristallini), bensì si dispongono in domini caotici, dando luogo ad un materiale amorfo: il vetro.

Rottura dei legami "a ponte" Si - O - Si (di tipo covalente) costituenti il vetro;

Formazione di legami "non a ponte" Na - O di tipo ionico;

Conseguente mobilità degli ioni Na+ quando la matrice

vetrosa è sottoposta ad alte temperature (300-400)°C

⇒ scambio ionico;

Diminuzione della rigidità della struttura del vetro $(\mathbf{T_g}\downarrow)$.

Il vetro ottico

Per vetro ottico si intende generalmente qualsiasi tipo di vetro purché avente caratteristiche che lo rendano adatto alla fabbricazione di componenti ottici come lenti o prismi.

Un vetro per definirsi *ottico* deve presentare:

- ➤ alti valori di isotropia (indice di rifrazione costante in ogni direzione);
- ➤ottima trasparenza e omogeneità;
- >capacità di subire lavorazione a freddo fino alla perfetta lucidatura;
- ➤ buona durabilità chimica;
- >assenza di difetti come bolle o strie;
- >assenza di tensioni interne.

Proprietà di un vetro ottico

Le proprietà ottiche di questa classe di vetri sono definite:

- dall'indice di rifrazione n;
- dalla variazione dello stesso in funzione della differente lunghezza d'onda della propagazione luminosa che lo attraversa (dispersione);

Generalmente i produttori di vetro forniscono il valore dell'indice alla lunghezza d'onda di 587 nm (riga D dello spettro di assorbimento dell'elio), mentre la dispersione è rappresentata dal **numero di Abbe**:

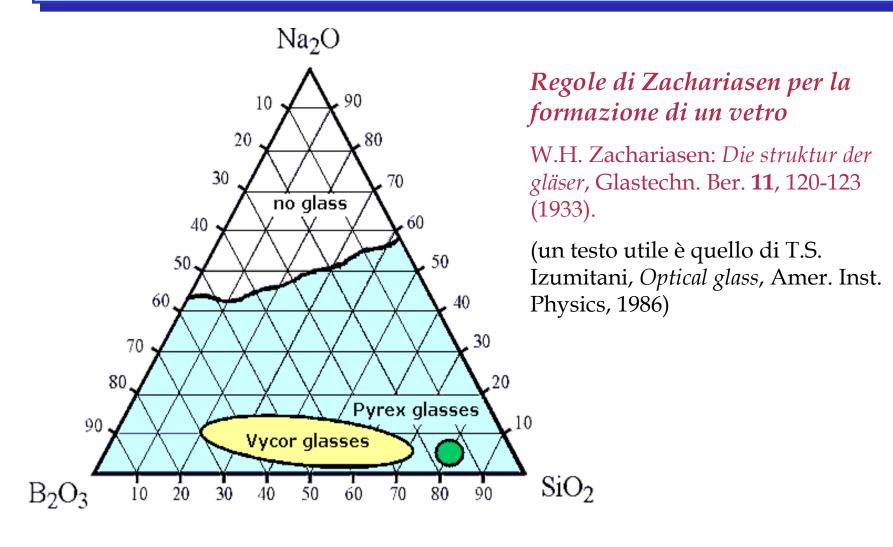
$$v = \frac{n_d - 1}{n_f - n_c}$$

 n_f : indice di rifrazione a $\lambda = 486.1$ nm n_a : indice di rifrazione a $\lambda = 656.3$ nm

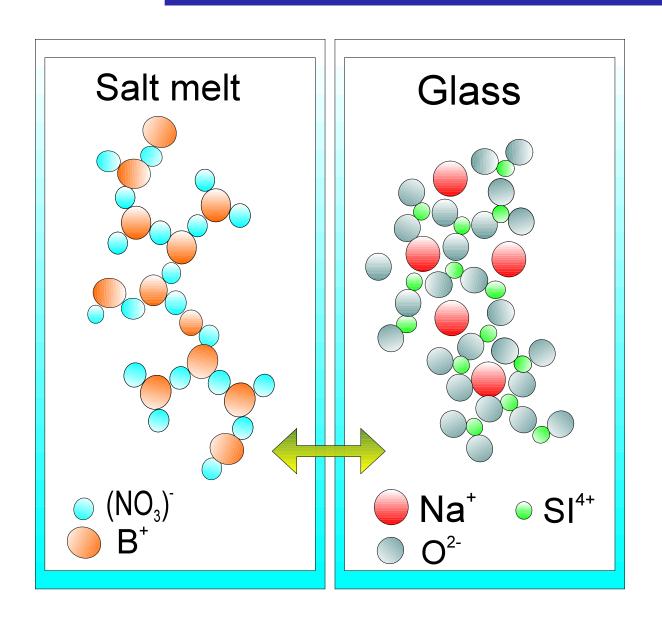
v > 55, vetro **crown** vetri poco dispersivi come i borosilicati BK7 della Schott;

v < 50, vetro flint vetri molto dispersivi come i vetri telluriti

Solo alcune composizioni danno luogo ad un vetro: esempio del diagramma di formazione per un vetro borosilicato



Struttura del vetro e scambio ionico

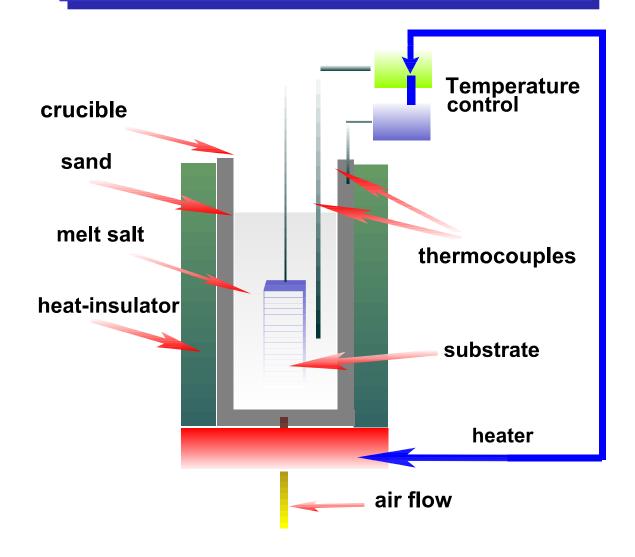


Ossido	Vetro			
033100	SODA-LIME			
SiO ₂	73.24			
Al_2O_3	1.46			
Na ₂ O	14.07			
K ₂ O	0.18			
CaO	6.45			
MgO	4.08			
SO ₃	0.34			
P ₂ O ₅				
CoO				
Fe ₂ O ₃	0.09			
TiO ₂				
ZnO				
Se				

Parametri principali degli ioni comunemente utilizzati per lo scambio ionico

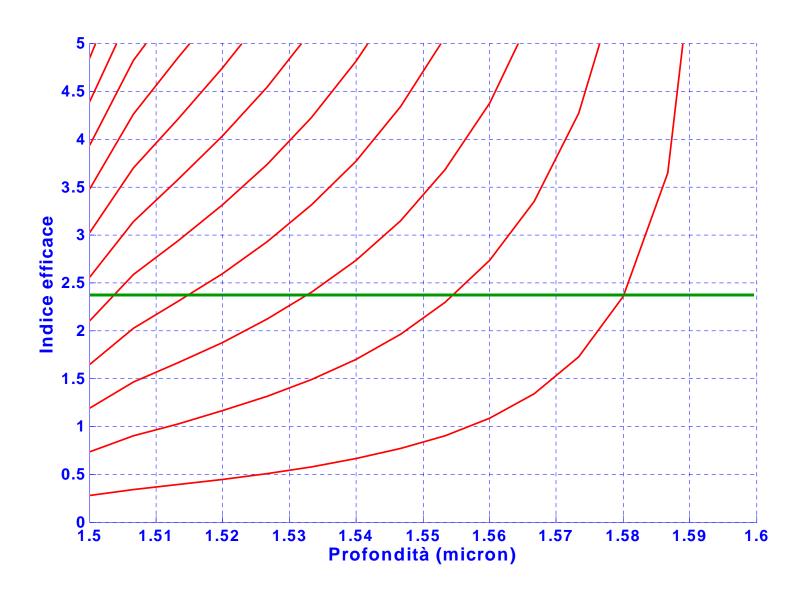
lone	Polarizzabilità elettronica (ų)	Raggio ionico (Å)	Sale	Temperatura di fusione (°C)	Δn	Temperatura di decomposizione (°C)	Dose letale LD50 (mg/Kg)
Na ⁺	0.41	0.95	NaNO ₃	307		380	1955 NaNO ₃
Li*	0.03	0.65	LINO ₃	264	0.030	600	710 LiCO ₃
Ag ⁺	2.40	1.26	AgNO ₃	212	0.090	444	2820 Ag ₂ O
K ⁺	1.33	1.33	KNO ₃	334	0.009	400	1894 KNO ₃
Rb ⁺	1.98	1.49	RbNO ₃	310	0.015	-	1200 RbCl
TI ⁺	5.20	1.49	TINO ₃	206	0.100	430	25 Tl ₂ S0 ₄
Cs⁺	3.34	1.65	CsNO ₃	414	0.030	-	1200 CsNO ₃

Lo scambio ionico



Forno ad aria per scambio ionico

Modi di una guida graded-index



Dinamica dello scambio ionico (I)

Flusso degli atomi dovuto alla diffusione: $\bar{j} = -D\nabla c$

Flusso degli atomi dovuto al campo elettrico: $\bar{j} = \frac{cDq\bar{E}}{flct}$ $D = \frac{\sigma kT}{cq^2}$

La somma dei due contributi per una specie ionica:
$$\bar{j}_{[a,b]} = -D_{[a,b]} \nabla c_{[a,b]} + \frac{c}{fkt} D_{[a,b]} eE$$
 (1)

Condizioni per la neutralità elettrica del vetro:

$$\boldsymbol{c}_{a} + \boldsymbol{c}_{b} = \boldsymbol{c}_{0} \qquad ; \qquad \nabla (\boldsymbol{c}_{a} + \boldsymbol{c}_{b}) = 0$$
 (2)

Flusso di corrente totale: $\overline{j}_0 = \overline{j}_a + \overline{j}_b$ (3)

$$1+2 \rightarrow 3 \qquad \Longrightarrow \frac{e\overline{E}}{fkT} = \frac{(M-1)\nabla c_a + M\overline{j}_0/D_a}{c_a(M-1) + c_0} \qquad \Longrightarrow \overline{j}_a = \frac{-D_a c_0 \nabla c_a + Mc_a \overline{j}_0}{c_a(M-1) + c_0} \qquad M = \frac{D_a}{D_b}$$

$$II \text{ Legge di Fick: } \frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot \overline{j}_a \qquad \overline{J} = \frac{\overline{j}_a}{c_0}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{D\nabla^2 C}{C(M-1) + 1} - \frac{D(M-1)(\nabla C)^2 + M\overline{J}_0 \cdot \nabla C}{[C(M-1) + 1]^2} \qquad \overline{J}_0 = \frac{\overline{j}_0}{c_0}$$

$$C = \frac{C}{C}$$

Dinamica dello scambio ionico (II)

Nel caso unidimensionale:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{D \partial C / \partial x}{C(M-1)+1} \right] - \frac{M \partial C / \partial x}{\left[C(M-1)+1 \right]^2}$$
Per lo scambio ionico termico
Diffusione
Trasporto

M=1:
$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - J_0 \frac{\partial C}{\partial x}$$

$$C(x,0) = 0$$

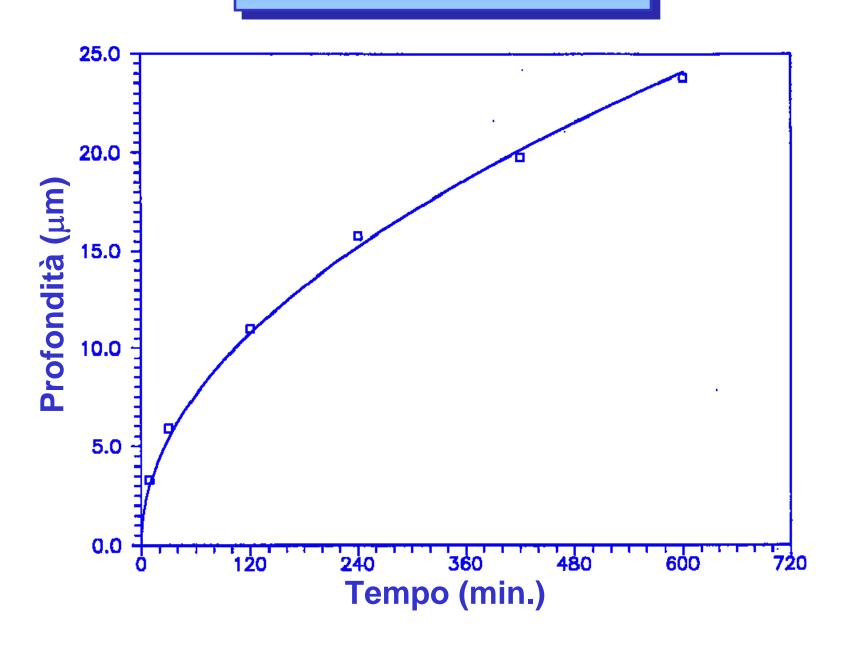
$$C(0,t) = C_0$$

$$C(x,t) = C_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \qquad \operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{z}^{\infty} e^{-t^2} dt$$

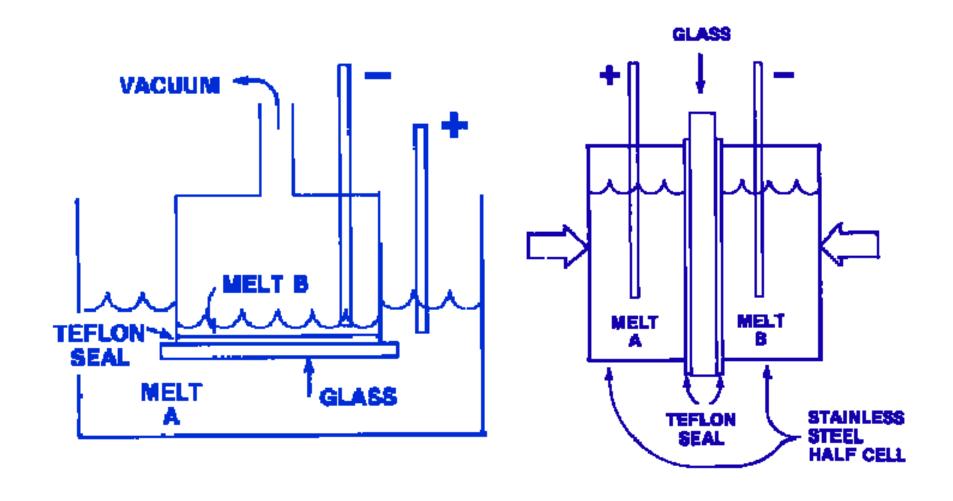
$$erfc(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{z}^{\infty} e^{-t^{2}} dt$$

Andamento della profondità della diffusione secondo radice quadrata del tempo.

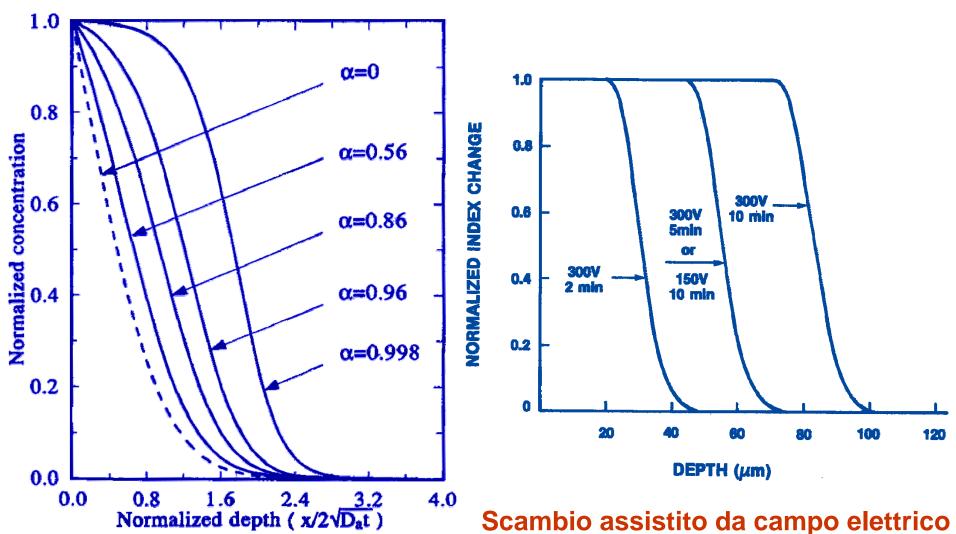
Velocità di diffusione



Scambio ionico con campo elettrico



Profilo d'indice



Scambio non assistito da campo elettrico

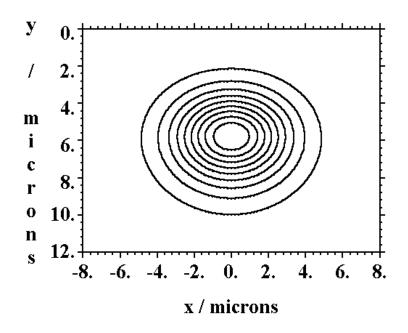
Scambio assistito da campo elettrico

Guide di superficie e sepolte

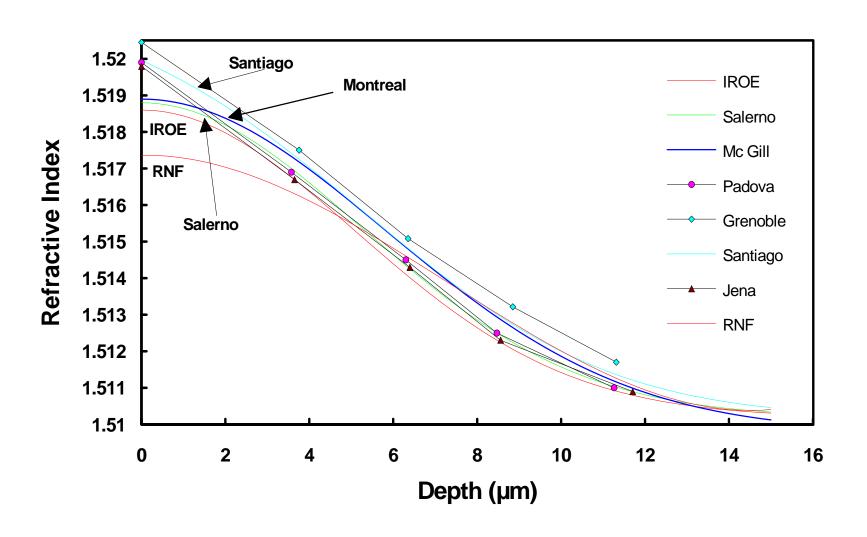
Guida di superficie

y 0. / 2. m 4. i 6. c r 8. o 10. n 12. -8. -6. -4. -2. 0. 2. 4. 6. 8. x/microns

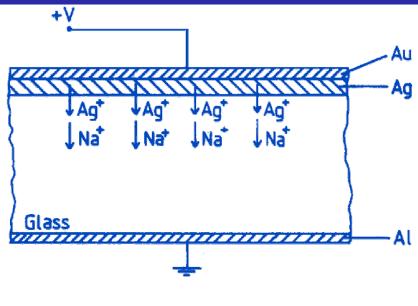
Guida sepolta

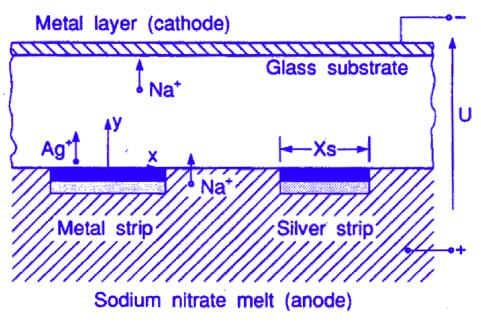


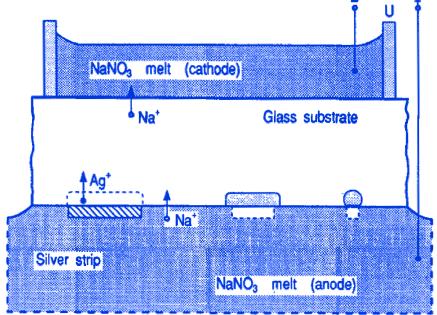
Precisione della determinazione del profilo d'indice



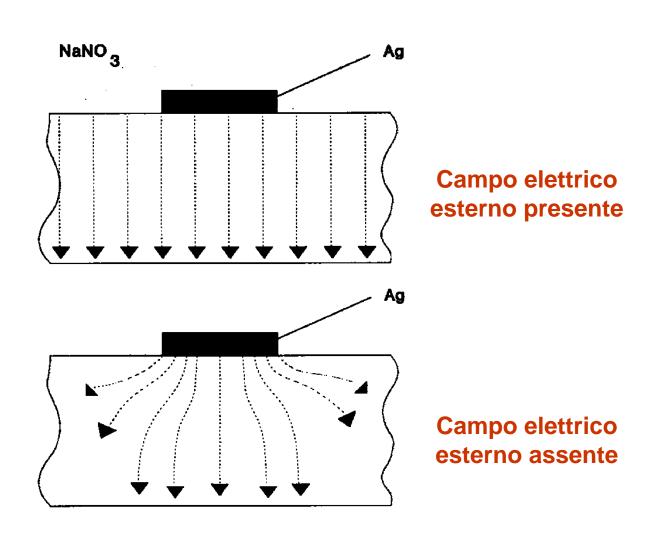
Diffusione da film sottile



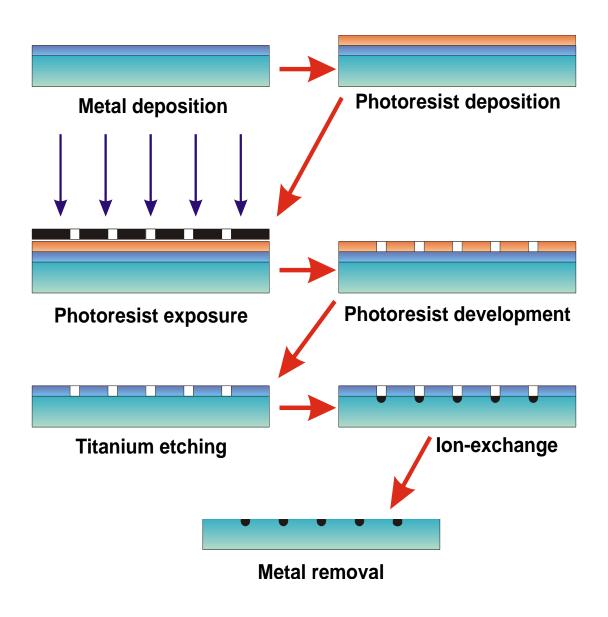




Diffusione ionica con campo elettrico: andamento del campo elettrico



Guide a canale mediante scambio ionico



II FOTORESIST

Pulizia substrato

Prime - Cottura a 200 °C per 30 minuti

Spinning - 4000÷6000 rpm, > 25 s

Softbake - 90-100 °C, 30 minuti.

Evaporano i **solventi** (*xilene*, acetato di butile e acetato di 2-etossietile) e aiuta l'adesione al substrato

Esposizione - qualche secondo a 350÷450 nm

Sviluppo

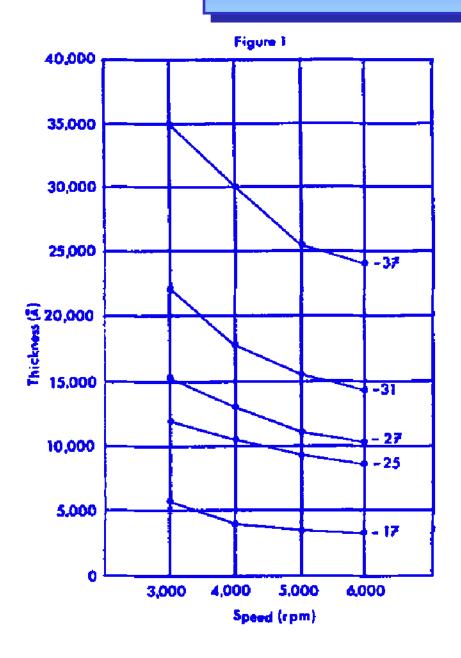
Hardbake - 110÷120 °C, 30 minuti

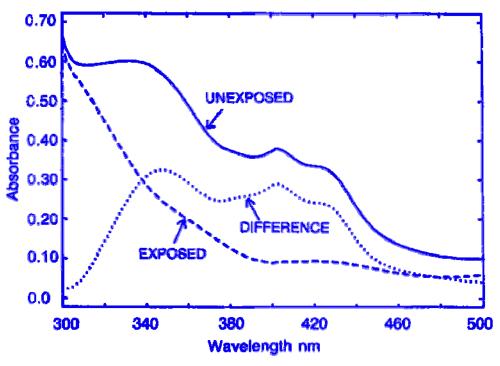
Consolida il fotoresist per i trattamenti di etching o lift-off

.....

Rimozione

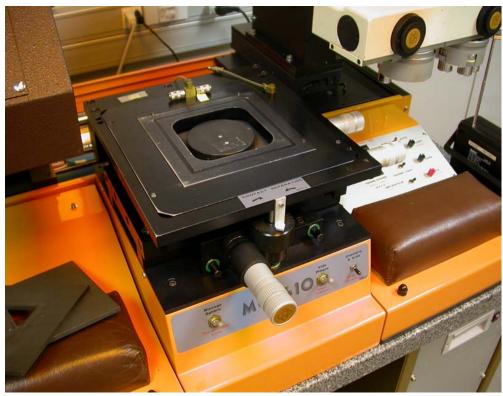
Caratteristiche del fotoresist





IL MASK ALIGNER





Annealing

Processo termico che in questo caso si fa seguire alla diffusione per incrementare la simmetria circolare della guida.

